

株式会社東京精密 2022年度(2023年3月期) 第3四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2023年2月6日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された2022年度(2023年3月期) 第3四半期決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
 - 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
 - なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」、前年同期比を「YoY」と表記します。
1. **3Q SPE 売上高は想定通りとのことだが、受注残高の水準、納期延伸要請、生産スロット調整の規模感などを踏まえ、詳細に解説いただきたい。**
 - まず2022年度下期のSPE売上計画は、4Qにやや偏重する計画になっている。
 - 3Qも納期延伸要請はみられた一方で、前倒し納入の要請もあり、生産スロット調整により対応した。この結果、当社想定線の着地となった。
 - なお、前倒しを希望する顧客の業種・地域などに特段の傾向は無い。
 2. **3QのSPE製品別受注高・売上高ならび前年同期比増減を伺いたい。**
 - 受注高：
 - 検査装置(プローバ)の構成比はほぼ50%、YoY半減に近い。
 - 加工装置は残り50%の構成比、YoY3割程度の減少。
 - 売上高：
 - 検査装置の構成比は約60%、YoY1桁%減少。
 - 加工装置は40%、YoY横ばい~微増。
 3. **3QのSPE業績に占めるパワー半導体・SiC関連比率、伸長率を伺いたい。また、会社のパワー半導体向けの事業機会は、加工装置中心という理解でよいか。**
 - 3QSPE受注に占めるパワー半導体(シリコン、SiC)比率は10%半ばと推定。プローバ・ダイサ・グラインダに対して幅広く需要があるが、SiCが占める割合は多くはないものと推定。
 - 「その他(メモリ、ロジック、電子部品、センサ、ディスクリット以外)」が

3QSPE 受注の 30%程度を占める。うち、SiC 基板の研削用途が半分程度を占めると推定。

- 以上から、3Q の広義でのパワー半導体関連の構成は、3Q SPE 受注の 20%前半～後半、うち SiC は 10%後半だったと推定。
- 足許 民生需要が軟調な中では目立っているが、急増はしていない。

4. 3Q SPE 営業利益率が 2Q 比で上昇している背景を聞きたい。

- 高水準の工場稼働、製品ミックス、経費の偏り(3Q<4Q)による。
- なお、消耗品売上高は 2Q 比ほぼ横ばい。
- 部材の市場調達コストが 3Q に急激に変化したとは認識していない。

5. 3Q に計上した特別損失（訴訟損失引当金繰入額）に関する詳細を伺いたい。

- 当社開発レーザダイサ装置に係る知的財産訴訟に関する損害賠償金の引当。
- なお、当該装置は既に販売を終了している。

6. 現在の SPE 製品納期を伺いたい。

- プローバ：概ね 8-10 か月だが、生産スロットの入れ替え等により、約 3 か月で出荷できる事例もある。
- ダイサ：概ね 3 か月程度で、通常納期の水準に戻っている。
- グラインダ：相対的に長い状況(1 年超)が継続している。

7. Advanced Package の分野では、CMP が事業機会になると思われる。現在の SPE 製品構成に占める CMP 比率を伺いたい。

- 現在、研削装置の構成はエッジグラインダ・高剛性研削盤(HRG)等が多く、CMP の構成は少ない。

8. 4Q は 3Q 比で増収の計画としているが、業績予想から逆算すると、大幅な減益が想定される。この背景を伺いたい。

- 偶数四半期に偏重する経費が存在することに加え、通期業績予想を据え置いたことで、計算上の調整が生じた部分があるをご理解いただきたい。

9. 11 月説明会では、SPE の受注見通しを、「2023 年 7-9 月期頃から回復を想定」、今回は「軟調な傾向が少なくとも半年は続く」としている。改めて見解を伺いたい。

- 市場予想は、2023 年の回復に懐疑的な見方がある一方、海外顧客との意見交換で、2023 年中頃からの設備投資再開の見方を示す声も聞かれた。
- 慎重にみる必要はあるが、「7-9 月期からの受注回復」の見方は維持したい。

- 見方は維持するが、7-9月期の回復は「緩やか」になると考えており、この点は11月説明会時点の見方から若干変更している。
- 回復のけん引役は、民生需要の回復と、11月説明会で述べた事業機会(注：Advanced Package, Hybrid Bonding, Wafer on Wafer等の新技術による開発・試作・量産の話材)であることには変更はない。

10. 計測の事業環境について、「自動車関連の回復は想定より遅いが、内需を中心とした需要が堅調」と説明されたが、その詳細を伺いたい。

- 国内で、計測機器の更新・入替え需要が一定程度存在する。
- 非自動車分野では、ロボット、(直近では停滞感があるものの)半導体、オートメーション、航空機分野などに動意がある。
- 総じて、コロナ禍で停滞基調にあった計測機器投資全般に回復基調がみられる。

11. 短期的に、SPE生産スロットの調整で出荷・売上の維持は可能か。民生需要の更なる停滞が、受注残を売上につなげられないリスクにならないか。

- 納期延伸依頼もあるが、一方で前倒しが可能な案件も存在する。現時点では、2022年度の業績予想を変更する必要はないと判断している。

12. SPEの受注残高は引き続き高水準(1,047億円)である。キャンセルリスクは無いか。2023年度は、この受注残高を根拠に、増収を期待してよいのか。

- 2023年度の業績見通しは現在精査中である。
- SPEの納期が全般に長期化する中においては、キャンセルリスクを大きく捉える必要はないと判断している。しかし、マクロ景気や最終製品の需要次第では、更なる納期延伸の可能性は否定できない。

13. 米国の対中貿易規制による影響は現時点であるのか。

- 現時点ではマイナス影響は出ていない。規制に備えた受注が既にあったのかどうかは判然としない。

14. 現在のSPEの中国向け比率や、アプリケーション動向を伺いたい。

- SPEの中国向け構成比は低い時期で20%、高い時期で40%程度であるが、足許では30%程度の構成比となっている。
- アプリケーション面では幅広い。ローエンドの電子部品からハイエンドのロジック半導体、またはパワー半導体関連の商談も多い。中国事業が特定のデバイスに集中していることはない。

15. 11月説明会では、対中規制により、中国の半分程度が影響を受ける可能性があると説明されていた。直近の米国・オランダ・日本政府による合意を受け、認識に変化あるか。また中国需要に実際に影響が出た場合、どのような変化が起こりえるか。
- 当社におけるリスクは、前工程からのウェーハアウトプット減少による、後工程の事業機会減少と考えられるため、具体的な影響は未知数である。
 - また、規制の詳細は現時点では判然としていたため、認識を変える必要はないと考えている。そもそも、中国向け売上の半分という認識について、定量的に精査した数字ではない。
 - 仮に、中国の需要減少があったとしても、他地域(米国、東南アジア等)に需要が移り、かつ当社の顧客自体は変わらない(既に取引実績を有する)と考えられるため、当社としては従来取引実績をもとにした商談が続くと想定している。
16. ウェーハ増産需要について、いわゆるグリーンフィールド(新工場建設)の投資による受注高・売上高のピークはいつ頃になるか。
- 足許の受注済案件には、グリーンフィールドと推察されるものも存在する。
 - これらが今後売上として認識されてゆく。従って、受注のピークは想定できないが、売上は安定的に推移してゆくものと想定する。
17. 名古屋地域で工場建設の検討を開始とのことだが、背景、生産規模を知りたい。
- 中長期の視点では、グライнда生産能力拡大が必要。
 - 現在、キャパシティの不足を補うため、グライнда生産の一部を子会社名古屋工場で行っている。
 - 既に一定の知見を有するため、当該工場近辺でキャパシティ増加を実行したいとの結論に至った。
 - 現時点では、候補地の検討中であり、生産規模等の回答はできない。
18. 名古屋地域での工場建設検討は、グライндаの事業機会の拡大を確信してのものか。
- その理解でよい。

以上